

股票代码：300131

股票简称：英唐智控

上市地点：深圳证券交易所



深圳市英唐智能控制股份有限公司

非公开发行股票

募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）

二零一九年四月

释 义

除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

| 一、普通词语 | | |
|-----------------|---|---|
| 本公司、公司、发行人、英唐智控 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 英唐智控本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为 |
| 本报告 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿） |
| 董事会 | 指 | 英唐智控董事会 |
| 赛格集团 | 指 | 深圳市赛格集团有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 二、专业术语 | | |
| 电子元器件 | 指 | 电子元件和电子器件的总称，系电子产品的基础组成部分。 |
| 芯片 | 指 | 半导体集成电路（Integrated Circuit），一种微型电子器件或部件，通过一定的工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等组件及布线互连在一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。 |

注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过200,500万元，在扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还银行贷款。

若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

公司已建立募集资金管理制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。

二、本次非公开发行募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）行业经营模式决定公司必须具备充足的流动资金

电子元器件分销行业具有“轻资产，重资金”的特点，即电子元器件分销行业对固定资产规模的要求较小，但对流动资金的要求较高。主要是因为电子元器件分销行业的上游为各品牌电子元器件制造企业，给予分销商的账期较短，特别是近年在电子元器件需求旺盛的情况下，一般要求分销商预付货款、货到付款或者给予较短的账期。而电子元器件分销商的下游主要为电子产品制造企业，普遍要求电子元器件分销商提供账期，导致电子元器件分销商在业务开展及实施过程中需要大量的资金并形成金额较大的应收账款、应收票据及预付账款。电子元器件分销行业普遍存在应收账款、应收票据及预付账款占总资产的比重较高，而固定资产等项目占总资产比重较低的情况。

截至2018年12月31日，公司及同行业主要可比上市公司的相关财务数据对比情况如下：

| 公司 | 流动资产占总资产比重 | 固定资产占总资产比重 |
|------|---------------|--------------|
| 深圳华强 | 61.02% | 2.82% |
| 力源信息 | 58.65% | 3.46% |
| 润欣科技 | 82.47% | 0.22% |
| 平均值 | 67.38% | 2.17% |
| 英唐智控 | 79.36% | 1.25% |

由上表可知，截至 2018 年 12 月 31 日，公司及同行业主要可比上市公司的资产构成中均以流动资产为主，固定资产占比较小，这体现了电子元器件分销企业的经营及发展更依赖于流动资金的持续投入的特点。拥有充足的流动资金是电子元器件分销企业持续经营及扩大规模的必要基础。

（二）提高盈利能力，为公司业务发展提供资金支持

近年来公司通过内部发展、收购、整合及合作获得了众多核心电子元器件品牌的代理权，技术型和资源型产品线愈发丰富，通过构建稳定的金字塔式产品结构形成了稳固的市场护城河，扩大了销售规模。

根据 Gartner 公司的数据，2018 年二季度中国市场服务器出货量和销售额分别同比增长 37.6% 和 75.9%，增速居全球首位。随着云计算基础设施的不断完善以及 5G 即将在 2020 年开启商用，物联网行业，特别是消费物联网领域将获得蓬勃的发展。

作为该等行业核心零部件主控芯片及存储器的分销商，公司将从上述行业的发展中获得增长红利。最近两年，公司围绕云计算及物联网行业的主控芯片、存储器等的销售情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 |
|-----------|------------|------------|
| 营业收入 | 576,101.63 | 184,306.97 |
| 营业收入同比增长率 | 212.58% | - |
| 净利润 | 12,229.44 | 3,640.60 |
| 净利润同比增长率 | 235.92% | - |

由上表可知，最近两年，公司围绕云计算及物联网行业的主控芯片、存储器等的营业收入及净利润规模呈现高速增长态势，未来随着该等领域的蓬勃发展，对相关电子元器件的需求持续增加，公司需投入更多的资金以扩大规模、提升盈利能力，在巩固和增强原领域既有优势地位的同时获得新领域的先发优势。

2016 年、2017 年及 2018 年，公司的营业收入分别为 422,205.71 万元、739,987.53 万元及 1,211,410.67 万元，保持高速增长态势。在销售规模迅速扩大的同时，公司也面临着营运资金压力，为了缓解营运资金压力，公司进行了较多

的债务性融资并带来较高的融资成本（截至 2018 年 12 月 31 日，公司债务性融资余额合计 293,865.68 万元，2018 年度公司利息支出为 17,441.77 万元），较高债务融资成本影响了公司的盈利能力。未来公司销售规模的扩大将进一步加剧营运资金压力，流动资金不足将成为掣肘公司发展的重要因素。

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合公司业务运营及发展需要，将会缓解公司资金压力，为业务的发展提供有力支撑，提高上市公司盈利能力。

（三）提高流动性，加强公司短期偿债能力

最近三年，随着上市公司营业收入规模快速扩大，应收款项增长较快，从而对上市公司经营资金占用相应增加。2016 年末、2017 年末及 2018 年末，上市公司应收账款及应收票据净额分别为 127,836.92 万元、194,931.96 万元及 253,009.44 万元，占各期末总资产的比重分别为 35.35%、38.10% 及 34.09%。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司待偿还的银行短期借款及一年内到期的银行长期借款的具体情况如下：

| 借款类型 | 借款余额（万元） |
|--------------|------------|
| 短期银行借款 | 145,355.57 |
| 一年内到期的长期银行借款 | 14,249.99 |
| 合计 | 159,605.56 |

营业收入规模的扩大，带来应收款项对流动资金占用金额的增加，同时上市公司面临较大的短期债务偿还压力，本次非公开发行募集资金用以补充流动资金及偿还银行贷款将有效提升公司的流动性，支撑业务的快速成长。

（四）优化资本结构，提高公司风险抵御能力

随着公司经营规模的不断扩大，公司资产负债率水平亦呈上升趋势，且增长较快。2016 年末、2017 年末及 2018 年末，上市公司的资产负债率分别为 46.10%、59.69% 及 67.32%。

截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司与同行可比上市公司的资产负债率水平对比情况如下：

| 序号 | 股票代码 | 上市公司简称 | 资产负债率 |
|------|--------|--------|--------|
| 1 | 000062 | 深圳华强 | 50.05% |
| 2 | 300184 | 力源信息 | 29.23% |
| 3 | 300493 | 润欣科技 | 39.55% |
| 平均值 | | | 39.61% |
| 英唐智控 | | | 67.32% |

注：上述数据根据上市公司定期报告计算得出。

由上表可知，截至 2018 年 12 月 31 日，同行可比上市公司的平均资产负债率为 39.64%，上市公司资产负债率为 67.32%，显著高于同行业可比公司水平。按照本次募集资金总额上限测算，本次发行后上市公司的资产负债率将降为 49.58%，将有效优化上市公司财务结构，提升上市公司的融资能力和提高风险抵御能力。

（五）缓解上市公司长期偿债压力

公司长期偿债压力主要来源于 2018 年面向合格投资者公开发行的公司债、长期应付款中的售后租回及融资租赁，以及长期借款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付债券、长期应付款中的售后租回、融资租赁，以及长期借款的具体情况如下：

| 债务名称 | 发行日/借款日 | 到期日 | 债券/借款余额(万元) |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2018 年面向合格投资者公开发行公司债（第一期） | 2018 年 1 月 3 日 | 2022 年 1 月 3 日 | 22,020 |
| 2018 年面向合格投资者公开发行公司债（第二期） | 2018 年 5 月 25 日 | 2022 年 5 月 25 日 | 13,897 |
| 2018 年面向合格投资者公开发行公司债（第三期） | 2018 年 8 月 17 日 | 2022 年 8 月 17 日 | 9,922 |
| 长期应付款中的售后租回 | 2018 年 4 月 12 日 | 2021 年 3 月 15 日 | 8,609.76 |
| 长期应付款中的融资租赁 | 2018 年 11 月 22 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 1,379.69 |
| 长期借款 | 2018 年 5 月 9 日 | 2020 年 4 月 29 日 | 2,882.54 |
| | 2017 年 5 月 26 日 | 2020 年 4 月 25 日 | 4,923.66 |
| 合计 | | | 63,658.25 |

由上表可知，公司长期偿债压力较大，后续在安排公司流动资金的同时，需要考虑未来偿还到期长期负债的资金需求，进一步加大了公司流动资金的压力，本次补充流动资金有利于缓解未来长期负债的资金压力。

综上所述，发行人本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，可在一定程度上满足发行人业务发展中的资金需求，有利于优化资本结构，有利于提高盈利能力和抗风险能力，降低发行人长短期偿债压力。本次募集资金使用计划符合发行人的发展战略，符合全体股东的利益，是必要、可行的。

三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产与净资产规模将进一步增加，将给公司在银行的授信评级和信贷额度带来积极的影响，提高公司财务弹性；同时能够降低财务费用，增强抗风险能力，降低短期偿债压力，符合公司的实际情况和战略需求。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次非公开发行完成后，通过补充流动资金及偿还银行贷款将提升公司自身业务规模及降低财务成本。因此，本次非公开发行后，公司的盈利能力将进一步增强。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次非公开发行完成后，募集资金的到位能改善公司现金流状况，降低公司的融资风险与成本。同时本次引入赛格集团作为上市公司的战略投资人，将进一步增强上市公司的融资能力，对上市公司现金流将产生积极的影响。

四、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项

公司本次募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还银行贷款，不涉及投资项目报批事项。

五、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次发行募集资金的用途合理、可行，有利于改善公司资本结构，降低公司资产负债率，提升公司资产流动性，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，促进公司持续、健康发展，符合本公司及本公司全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》之盖章页）

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2019年4月30日